



华冠半导体

广东华冠半导体有限公司  
Guangdong Huaguan Semiconductor Co., Ltd.

制图 赖谊成  
审阅 罗云龙

核准 林钟涛

DIP24 (300ML)

文件名称:  
HG-DIP24 (300ML)

文件编号:  
HGWT-230036

版本 V1.0

比例 1:1

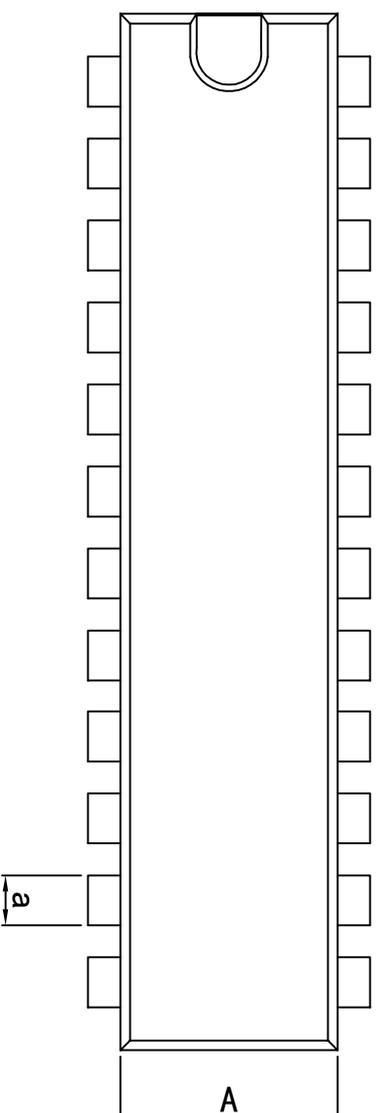
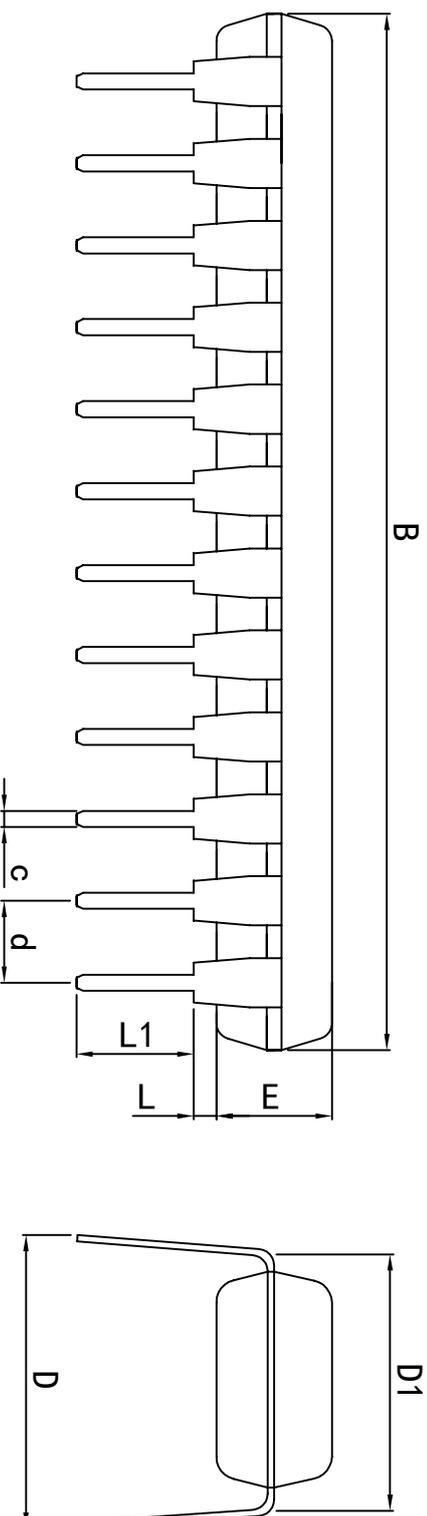
单位 mm

日期 2023-6-30

图纸幅面 A4



第一角法



UNITT: mm

DIM.	A	B	D	D1	E	L	L1	a	C	d
MIN	6.10	28.9	8.10	7.42	3.10	0.50	3.00	1.50	0.40	2.54
MAX	6.68	32.1	10.9	7.82	3.55	0.70	3.60	1.55	0.50	BSC